

导热硅胶薄材/XK- R25

简介:

XK-R 系列为无基材硅胶导热薄材, 比传统玻纤布更好的导热与填缝能力,导热系数 1~4.8W/mk , 比传统硅胶片更薄的界面厚度(BLT), 适合 0.2~0.5mm 范围的价格竞争的应用

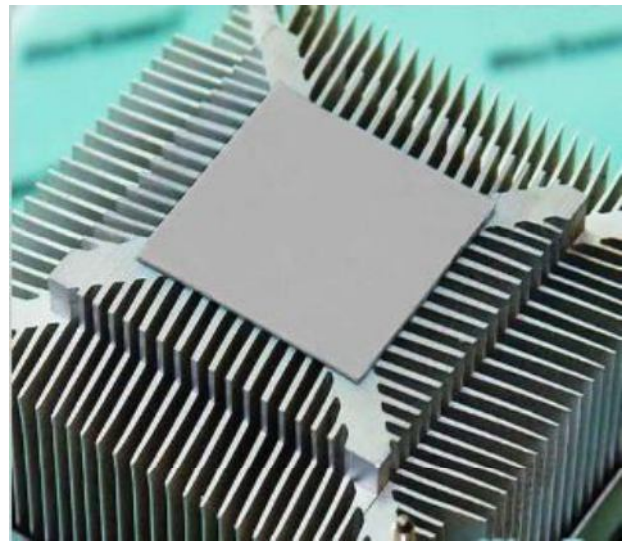
特性:

超薄厚度(0.2~0.5mm)

无基材设计

适当的压缩性

高性价比



应用:

消费性电子产品

自动化设备

军规设备.

医疗设备

	unit	XK-R25	Method
Reinforcement Carrier		NA	
Color		Dark Gray	
Thickness	mm	0.2~10	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm ³	2.8	ASTM D792
Hardness	Shore A	30	ASTM D2240
Thermal Conductivity	W/mK	2	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV/mm	15	ASTM D149
Dielectric Constant	1	6.5	ASTM D150
Application temperature	°C	-50~200	
Tensile strength	psi	90	ASTM D149
Elongation	%	100	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	<0.01	GC-FID
Flammability	UL94	V-0	UL94